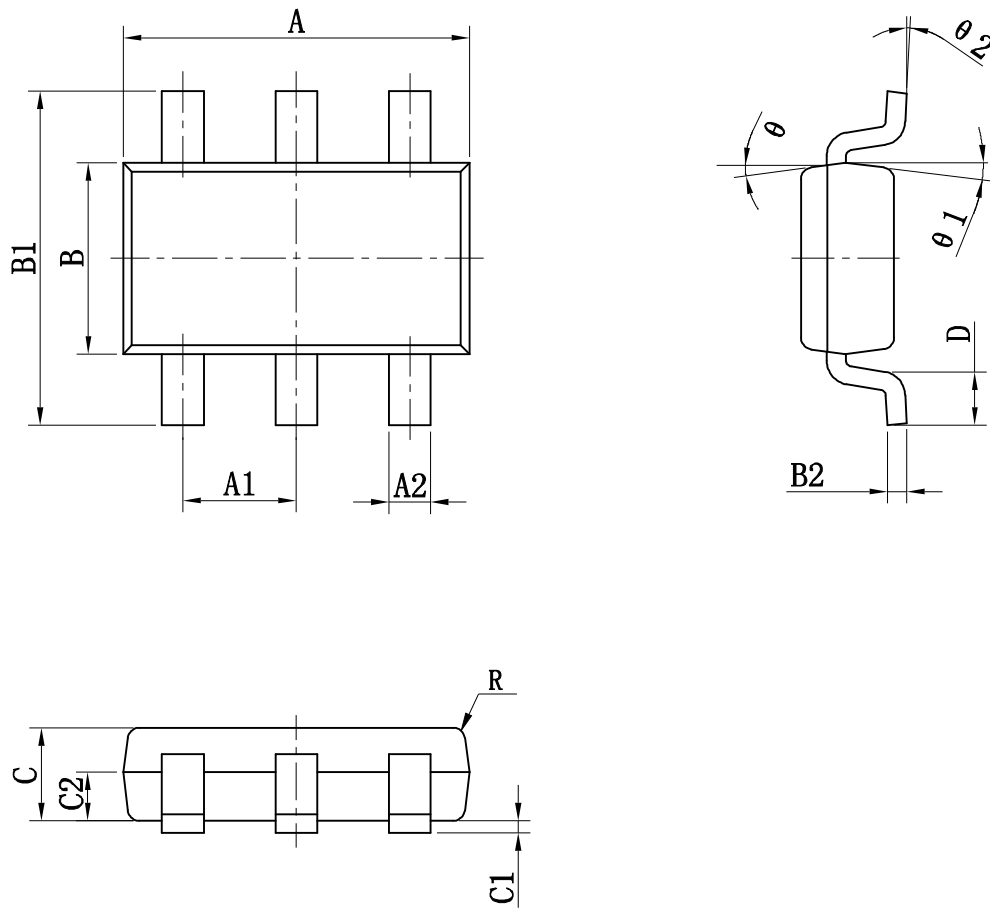




| 标注/<br>SYMBOL | 尺寸/<br>SIZE | 最小/MIN(mm)  | 最大/MAX(mm) | 标注/<br>SYMBOL | 尺寸/<br>SIZE | 最小/MIN(mm) | 最大/MAX(mm) |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|
| A             |             | 2.820       | 3.020      | C1            |             | 0.000      | 0.100      |
| A1            |             | 0.950 (BSC) |            | C2            |             | 0.378      | 0.438      |
| A2            |             | 0.350       | 0.500      | D             |             | 0.300      | 0.600      |
| B             |             | 1.600       | 1.700      | $\theta$      |             | 9° TYP4    |            |
| B1            |             | 2.650       | 2.950      | $\theta 1$    |             | 10° TYP4   |            |
| B2            |             | 0.080       | 0.200      | $\theta 2$    |             | 0~8°       |            |
| C             |             | 0.700       | 0.800      |               |             |            |            |



|    |     |            |          |            |                                  |     |
|----|-----|------------|----------|------------|----------------------------------|-----|
| 制图 | 邓景勇 | 2018.04.03 | 名称       | 生效日期       |                                  |     |
| 审核 |     |            | TSOT23-6 | 等级标记       | 重量                               | 比例  |
| 批准 |     |            | 封装产品图    |            |                                  | 1:1 |
| 单位 | mm  |            | 图号       | 页数         | 第1页 共1页                          |     |
| 镀涂 |     |            | C-OL-053 | 气派科技股份有限公司 |                                  |     |
|    |     |            | 版次       | E          | CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd |     |